

光プロセスの基礎過程に迫る 計測・モニタリング技術の進展

Progress of characterization and monitoring techniques
that reveal fundamental of light process

開催日時：2019年3月10日(日) 13:30~18:15

場所：東京工業大学 大岡山キャンパス M114

光による材料プロセッシングは、三次元造形、難加工材料切断、材料接合、材料合成など多岐にわたり、そのプロセスには光化学反応、イオン化、衝撃発生、熔融など多様な現象が関わっています。そこで、光プロセスの計測・モニタリングに焦点を当て、今後の光プロセスの高度化に向けた展望について議論する場をつくるため本シンポジウムを企画しました。現象のモニタリングには、X線からテラヘルツ領域までの広い波長範囲の計測、高速時間分解イメージングなど、高度な計測技術が用いられており、幅広い分野の研究者が刺激を受け、新たな計測・モニタリング技術創出のきっかけになることを期待しております。

【招待講演者（敬称略）と講演タイトル】

- 瀧健太郎（金沢大学）
「355 nmレーザーと高速FT-IRを組み合わせたステレオリソグラフィ用UV硬化樹脂の硬化挙動の解析」
- 谷峻太郎（東京大学）
「レーザープロセスの基礎過程解明にむけた大規模データ解析」
- 佐藤雄二（日本原子力研究開発機構）
「高輝度X線を用いたレーザー照射時の粉末粒子の熔融挙動観察とスパッタレスSLM法の開発」
- 早崎芳夫（宇都宮大学）
「フェムト秒レーザー生成現象の時間分解デジタルホログラフィ」
- 山岸里枝（福岡工業大学）
「レーザーアブレーション現象の短パルスレーザー照明を用いた可視化観察」